

STEP-Z

Interne TE-Nummer 6-1761614-2

PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 200 Position, 1.3 mm

[.051 in] Centerline, Partially Shrouded, Gold, Surface Mount -

Solder Ball

[Auf TE.com ansehen>](#)

Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Leiterplattenstiftleisten und -buchsen

PCB-Steckverbindermontagetyp: **Stiftleiste für die Leiterplattenmontage**Montageausrichtung für Leiterplatte: **Vertikal**Steckverbindersystem: **Leiterplatte-an-Leiterplatte**Anzahl von Positionen: **200**Zeilenanzahl: **2****Eigenschaften****Produktmerkmale**

PCB-Steckverbindermontagetyp	Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
Steckverbindersystem	Leiterplatte-an-Leiterplatte
Stecksockeltyp	Teilweise ummantelt
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Stapelbar	Ja
Montageausrichtung für Leiterplatte	Vertikal
Anzahl von Positionen	200
Zeilenanzahl	2
Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration	Parallel

Elektrische Kennwerte

Spannungsfestigkeit (max.)	500 VAC
Isolierwiderstand	18 MΩ
Arbeitsspannung	48 VAC

Sonstige Eigenschaften

Primäre Produktfarbe	Naturbelassen
----------------------	---------------

Kontaktmerkmale

Kontaktaufbau	Matrix
Flachkontaktbreite	1 mm[.04 in]
Flachkontaktdicke	.2 mm[.008 in]
Kontaktform	Doppelstrahl, Doppelstrahl, Einzelstrahl, Quadratisch
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Zinn-Silber
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Gold
Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts	.76 µm[29.9212 µin]
Kontakttyp	Flachstecker
Kontakt-nennstrom (max.)	1 A

Klemmenmerkmale

Verbindungsmethode für Leiterplatte	Oberflächenmontage – Lotkugel
-------------------------------------	-------------------------------

Montage und Anschlusstechnik

Gegensteckarretierung	Mit
Gegensteckführung	Ohne
Arretierung für Leiterplattenmontage	Ohne
Montageausrichtung der Leiterplatte	Ohne
Art der Steckverbinder-montage	Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

Raster	1.3 mm[.051 in]
Gehäusematerial	Thermoplast, Thermoplast

Abmessungen

Steckverbinderhöhe	12.95 mm[.509 in]
Reihenabstand	2 mm[.079 in]
Stapelhöhe	17 mm, 23 mm, 27 mm[1.063 in]
Leiterplattendicke (empfohlen)	1.57 mm[.8 in]

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	0 – 100 °C[32 – 212 °F]
---------------------------	-------------------------

Betrieb/Anwendung

Satzverarbeitungsfunktion	Keine
Stromkreis Anwendung	Strom und Signale

Industriestandards

UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0
----------------------	----------

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	25
Verpackungs-Typ	Einsatz

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [TE.com](https://www.te.com) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2023 (233) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogenen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Reflow-Löten tauglich bis 260 °C

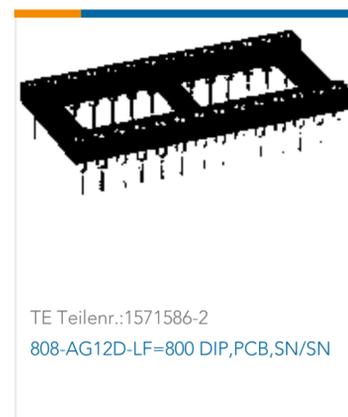
Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



Kunden kauften auch diese Produkte



Dokumente

Produktzeichnungen

[STEP-Z PLUG 12MM 200P LF ST](#)

Englisch

CAD-Dateien

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_6-1761614-2_B.2d_dxf.zip](#)

Englisch

[3D PDF](#)



3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_6-1761614-2_B.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_6-1761614-2_B.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

[STEP-Z Interconnection System](#)

Englisch

Produktspezifikationen

[Anwendungsspezifikation](#)

Englisch